

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

## 露笑科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20211126

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	易方达基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券资产管理有限公司、安信证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司
时间	2021年11月26日
地点	安徽省合肥市长丰县合肥露笑半导体材料有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李陈涛、合肥露笑董事长 程明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者问答</p> <p>一、公司公告与东莞市天域半导体科技有限公司签署战略合作协议，为其2022年、2023年、2024年预留产能不少于15万片，并同时公告非公开发行股票预案进行扩产，如何理解？</p> <p>答：这里主要有两层理解。首先，签署长单绑定产能是行业内通用的做法，像国外导电型衬底集中在Wolf speed、罗姆公司、二六公司，安森美、英飞凌、意法半导体等下游厂家都签署长期订单来保证原材料的供应不受影响。这样做的根本原因在于碳化硅衬底片供不应求，下游厂商需要以长协订单形式来绑定上游产能。</p> <p>更深层次的理解，碳化硅衬底要想获得下游客户长期订单</p>

**投资者关系活动  
主要内容介绍**

需要具备三点：一是要通过客户认证，具有稳定的质量，一致性控制要求比较高；二是需要有一定规模的、稳定的供应量；三是具备与客户需求相匹配的扩产能力。公司与东莞天域签署战略合作协议，为其 2022 年、2023 年、2024 年预留碳化硅衬底产能不少于 15 万片，标志着公司产品和产能已经得到东莞天域的认可，绑定公司未来三年产能。

非公开发行股票预案主要是将来用以扩产来匹配包括东莞天域等厂家不断扩张的衬底需求。

**二、公司碳化硅的技术来源？**

答：目前碳化硅市场主要是 3 大技术流派，一个是北京中科院物理研究所陈小龙团队，2003 年开始做碳化硅，之后加盟天科合达；第二个是山东大学徐现刚教授团队，目前在广州南砂；第三个是中科院上海硅酸盐所陈之战教授团队，陈博士最早接触碳化硅，2008 年建立国内第一条 2 英寸中试线，2012 年在世纪金光建立了 4 英寸中试线，之后陈博士团队加入我公司，并与公司原蓝宝石团队进行磨合，确定了碳化硅衬底片的主要技术路线，其中切磨抛以原蓝宝石技术为基础发展而成。

**三、公司衬底片未来的产能规划情况。**

答：目前公司现有的衬底片年产能为 2.5 万片，后续将根据市场订单情况继续进行扩产，预计到明年 6 月份之前，公司将年产能扩大到 10 万片。

**四、公司未来的研发投入方向？**

答：半导体属于资金和技术密集型行业，预计公司将在未来持续加大研发投入，增强公司竞争力。主要研发投入有三个方向：1、研究提高碳化硅衬底良品率的新技术，降低生产成本；2、研究加工新工艺、新技术；3、研究开发 8 英寸碳化硅衬底片，增强市场竞争力。

	<p><b>五、介绍下碳化硅市场情况。</b></p> <p>答：据 Yole 预测，碳化硅器件应用空间将从 2020 年的 6 亿美金快速增长至 2030 年的 100 亿美金。II-VI 公司乐观预计 2030 年碳化硅市场规模将超 300 亿美元，2021 到 2030 年复合增速高达 50.6%。而据国内行业资深专家测算，至 2030 年前后 6 英寸碳化硅市场需求量将达 1000 万片以上，未来碳化硅供不应求格局将长期存在。</p> <p><b>六、目前碳化硅市场整体竞争格局如何？</b></p> <p>答：目前碳化硅导电型衬底的供给主要集中在海外巨头，美国 Wolfspeed、罗姆公司、二六公司占据绝大部分市场份额。国内近年才开始爆发，各级政策联动，扶持力度增强，市场不断有竞争者加入。我们认为今年是国内碳化硅产业布局元年，明年是送样年，后年行业会进行洗牌，届时真正掌握核心技术、有能力的公司将会市场中脱颖而出，露笑努力成为国内第一家真正量产 6 英寸导电型衬底的上市公司。</p>
<b>附件清单(如有)</b>	无
<b>日期</b>	2021 年 11 月 26 日